

Leiterplatten und Baugruppen

	Leiterplatten	Baugruppen
Produkte	• Hochstromleiterplatten • in Kupfer-Inlaytechnologie • Metallkern (Alu) einlagig und zweilagig • HDI Leiterplatten • starrflex und flexible Leiterplatten • Dünnlamine	• Prototypen und Musterbestückung ab 1 Stück • typische Serien von 10 bis ca. 1.000 Stück pro Los • Komplettierung und Verdrahtung • Gerätemontage • Inbetriebnahme und Prüfung
Lieferzeit	• ab 3 AT Express • ab 6 AT für Muster und Kleinserien • ab 12 AT für Serien • ab 20 AT für Großserien	• EmsXpress Service • ab 3 AT • Prototypen ca. 15 AT • Serien ab ca. 25 AT
Oberfläche	• HAL • chemisch NiAu / Steckergold • chemisch Sn / chemisch Ag	• Verarbeitung nach RoHS, Reach • Schutzlackierung • Verguss in verschiedenen Ausführungen
Drucke	• Lötstopp und Kennzeichendruck • in verschiedenen Farben	• Pastendruck mit Jet Print • Schablonendruck für SMD-Kleber und Lötpasten
Konturbearbeitung	• Konturfräsen, Tiefenfräsen • Ritzen	• Kühlkörper-Bearbeitung und Montage • Gehäuse und Frontplattenfertigung
Material	• FR4 von 0,1 – 3,2mm; Flex 0,05 mm • Sondermaterialien	• Materialbeschaffung komplett • auch schwer beschaffbare bzw. obsolete Bauelemente • Kundenbeistellung
Service	• Design-Rule-Check • Erstellung des Leiterplattenlayouts • Erstellung der Leiterplattendaten • Erstellen von Stromlaufplänen	• Unterstützung bei der Entwicklung elektronischer Baugruppen • Stücklistenausarbeitung • schnelle Prüfung auf Materialverfügbarkeit • Erstellung von Prüfprotokollen und Dokumenten
Kundendaten	• ODB++ • Eagle, Target, Gerber, KiCard • Altium	• ODB++ • Eagle, Target, Gerber, KiCard • Stücklisten und Bestückungszeichnungen
Qualitätssicherung	• optische Kontrolle / AOI • elektrischer Test / Erstmusterprüfung	• AOI, Röntgen • Prüfung und Inbetriebnahme nach Kundenvorschrift